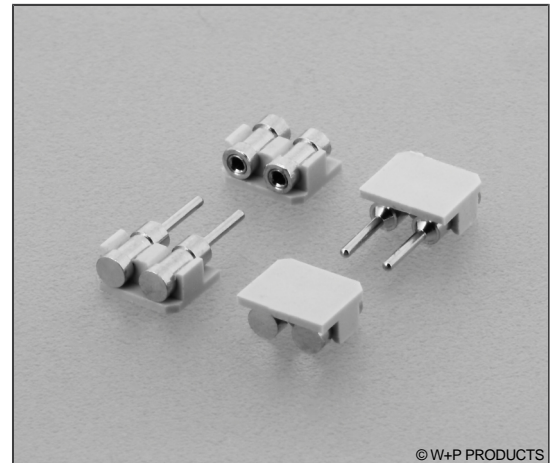


5251

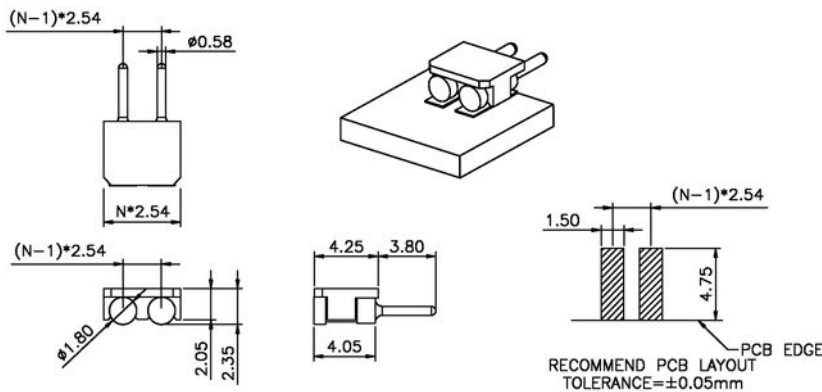
LED Verbinder RM 2,54mm LED Connectors 2.54mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

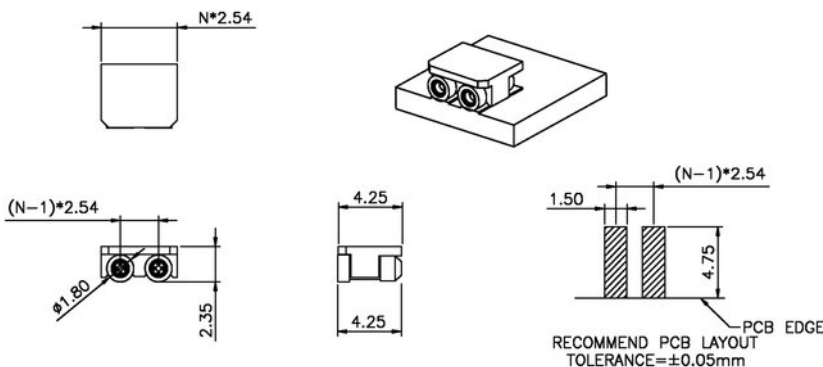
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 HB (UL94 V-0 auf Anfrage) <i>Thermoplastic, rated UL94 HB (UL94 V-0 on request)</i>
Farbe <i>Colour</i>	Weiß (UL94 HB), beige, schwarz (UL94 V-0) <i>White (UL94 HB), beige, black (UL94 V-0)</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ <i>< 10mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC} <i>500V_{AC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A @ 36V _{DC} <i>3A @ 36V_{DC}</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C <i>-55°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	260°C max. für 3-5s <i>260°C max. for 3-5s</i>



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Version	Colour*	Plating*	Package
5251	02 02-10	1 1 Stifte Male	30 30 Weiß (UL94 HB) White (UL94 HB) 20 Beige (UL94 V-0) Beige (UL94 V-0) 10 Schwarz (UL94 V-0) Black (UL94 V-0)	00 00 Au	TR TR Tape & Reel



Series	Contacts*	Version	Colour*	Sleeve Plating*	Clip Plating*	Package
5251	02 02-10	2 2 Buchsen Female	30 30 Weiß (UL94 HB) White (UL94 HB) 20 Beige (UL94 V-0) Beige (UL94 V-0) 10 Schwarz (UL94 V-0) Black (UL94 V-0)	00 00 Au	00 00 Au	TR TR Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

